

前次募集资金使用情况专项说明

经中国证券监督管理委员会核准,本公司于1998年8月14日发行新股。发行股份12,000万股,发行股价人民币6.53元,募集资金总额为人民币783,600,000.00元,扣除发行费用人民币15,479,578.30元后实际募集资金数额为人民币768,120,421.70元。资金到位时间为1998年8月24日,业经大华会计师事务所以华业字(1998)第969号验资报告验证。

大华会计师事务所有限公司对本公司截止2001年12月31日前的前次募集资金投入情况进行了审核,并出具了《前次募集资金使用情况专项报告》【华业字(2002)第372号】。

一.前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金的实际使用与收益情况:

金额单位:人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 实际投 | | 实际投入时间 | | | | 完工程度 | 产生收益 |
|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|------------|
| | | 资金额 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | | |
| 1 | 建设通信产品用IC生产基地 | 14,856.30 | 5,895.00 | 3,447.30 | 5,514.00 | - | - | 100% | (注1) |
| 2 | 建设金卡工程IC芯片生产基地 | 10,348.37 | 3,035.00 | 2,312.30 | 1,809.23 | 2096.49 | 1095.35 | 42.99% | (注1) |
| 3 | 模糊控制专用IC芯片技术开发 | 1,597.60 | 424.00 | 1,049.70 | 123.90 | - | - | 100% | (注1) |
| 4 | 流动资金 | 11,150.00 | 1,700.00 | 7,161.70 | 2,288.30 | - | - | 100% | |
| 5 | 收购北电网络在上海先进半导体有限公司的全部股权 | 12,492.24 | | | 12,492.24 | - | - | 100% | 16,045(注2) |
| 6 | 收购上海虹日国际电子有限公司25.5%股权 | 1,270.00 | | 1,270.00 | - | - | - | 100% | 991(注2) |
| 7 | 建造数模混合集成电路专用生产厂房 | 11,375.86 | | | | 6947.25 | 4428.61 | 100% | |
| | 合计 | 63,090.37 | 11,054.00 | 15,241.00 | 22,227.67 | 9043.74 | 5523.96 | - | - |

注1:募集资金投入的通信产品用IC生产基地、金卡工程IC芯片生产基地、模糊控制专用IC芯片技术开发三个项目所产出的三大类产品,于1999年初至2002年末累计实现销售收入人民币92,533万元,销售毛利人民币37,628万元。

注2:系根据上海贝岭股份有限公司所持股权比例按照权益法核算的投资收益。

(二)项目进展情况说明

1.截止2001年12月31日公司的以下项目均已完工:

- (1)建设通信产品用IC生产基地
- (2)模糊控制专用IC芯片技术开发
- (3)收购上海先进半导体制造有限公司34%股权
- (4)收购上海虹日国际电子有限公司25.5%股权
- (5)流动资金

2.截止2001年12月31日尚未完工的建设金卡工程IC芯片生产基地项目和建设数模混合集成电路专用生产厂房项目的情况说明如下:

(1)募集资金投入的建设金卡工程IC芯片生产基地项目:

2002年金卡工程项目完成新品开发项目七项,其中六个产品通过R1认证,五个产品通过产品鉴定,四个产品做到当年开发,当年完成鉴定,当年形成销售。2002年第二季度完成质量认证的新品7448S在第三季度开始上市销售,BL7432LV等新品顺利出样,

BL24LC32 等产品已完成设计工作。完成四款嵌入式 EEPROM 类 ASIC 电路的质量认证和产品鉴定。金卡类产品在 2002 年度实累计实现销售收入 3120 万元,其中新品销售收入占 70% 以上,实现销售利润 1,068.49 万元。

(2)募集资金投入的建设数模混合集成电路专用生产厂房项目：

建造数模混合集成电路专用生产厂房屋于 2001 年 7 月 20 日开工,在 2001 年所有建筑物进行全面施工阶段,动力厂房建筑结构已封顶,工程师楼及行政办公楼结构至二楼,主厂房(硅片制造车间)采用超大跨度 62.05 米重钢结构于 2002 年 1 月结构封顶。

2002 年度数模混合集成电路专用生产厂房建筑安装工程基本完成,正处于准备竣工验收。

二.募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照

(一)募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 实际投资金额 | 招股说明书 承诺金额 | 差异说明 |
|----|-----------------------------|-----------|---------------|--|
| 1 | 建设通信产品用 IC 生产基地 | 14,856.30 | 16,600.00 | 结余 1743.70 万元已调整至建造数模混合集成电路厂房项目 |
| 2 | 建设金卡工程 IC 芯片生产基地 | 10,348.37 | 24,070.00 | 项目尚未完成(注) |
| 3 | 增添 6 英寸亚微米生产线专用设备 | 0.00 | 24,900.00 | 项目取消 |
| 4 | 模糊控制专用 IC 芯片技术开发 | 1,597.60 | 597.60 | 调整增加投资人民币 1000 万元 |
| 5 | 改造扩建公司净化厂房 | 0.00 | 24,900.00 | 项目取消 |
| 6 | 发展兼并后的上海华旭微电 子公司封装分厂 | 0.00 | 1,050.00 | 项目取消,原计划投资的人民币 1,050.00 万元已调整至建造数模混合 集成电路厂房项目。 |
| 7 | 流动资金 | 11,150.00 | 11,150.00 | 无差异 |
| 8 | 收购北电网络在上海先进半 导体有限公司的全部股权 | 12,492.24 | 0 | 调整新增项目,结余人民币 1,507.76 万 元已调整至建造数模混合集成电路厂 房项目。 |
| 9 | 收购上海虹日国际电子有 限公司 25.5% 股权 | 1,270.00 | 0 | 调整新增项目,结余人民币 30 万元已 调整至建造数模混合集成电路厂房项目。 |
| 10 | 建造数模混合集成电路专 用生产厂房 | 11,375.86 | 0 | |
| | 合计 | 63,090.37 | 103,267.60 | |

注：未达到计划进度的说明：

由于金卡大规模的推广使用与市场配套条件有很大关联,金卡市场有一个逐步培育、成熟的过程,为谨慎起见本公司对金卡工程 IC 芯片生产基地投入资金的速度力求与金卡市场需求的速度同步,近二年在金卡基地实际投入和产出的节奏与计划投入产出的要求明显滞后一段时间。

(二)募集资金项目变更调整情况

1.公司于 1999 年 11 月 9 日召开第一届第七次董事会决定对募集资金作如下调整：

- (1) 取消原 " 增添 6 英寸亚微米生产线专用设备 " 项目；
- (2) 取消原 " 改造扩建公司净化厂房 " 项目；
- (3) 出资 1500 万美元收购北电网络公司在上海先进半导体制造有限公司的全部股权；
- (4) 出资 153 万美元收购上海虹日国际电子有限公司 25.5% 的股权；
- (5) 对原 " 模糊控制专用 IC 芯片技术开发 " 项目追加 1000 万元人民币投资。

该募集资金变更方案业经 1999 年 12 月 16 日召开的公司 1999 年度第二次临时股东大会通过。

经过上述项目调整后募集资金的使用计划如下：

| 项目名称 | 计划总投资(人民币万元) |
|------------------|--------------|
| 建设通信产品用 IC 生产基地 | 16,600 |
| 建设金卡工程 IC 芯片生产基地 | 24,070 |
| 模糊控制专用 IC 芯片技术开发 | 1,597.6 |
| 华旭封装分厂 | 1,050 |
| 收购先进 34% 股权 | 14,000 |
| 收购虹日公司 25.5% 股权 | 1,300 |
| 流动资金 | 11,150 |
| 其它(注) | 7044.4 |
| 合计 | 76,812 |

注：其它类金属项目调整后节余资金人民币 7,044.4 万元。

2.公司于 2001 年 3 月 9 日召开一届十一次董事会,对募集资金进行了调整：

(1)取消 " 发展兼并后的华旭封装分厂生产线 " 项目(原计划投资的人民币 1,050.00 万元已调整至建造数模混合集成电路厂房项目)；

(2)结余的募集资金共计人民币 11,375.86 万元用于投资建设数模混合集成电路芯片专用生产厂房,该项目的建设总投资为人民币 24,813.00 万元,不足部分由公司自筹资金解决。

该项募集资金调整方案业经 2001 年 4 月 13 日召开的公司 2000 年度股东大会通过。

经过上述项目调整后募集资金的使用计划如下：

| 项目名称 | 计划投资(人民币万元) |
|-------------------------|----------------|
| 建设通信产品用 IC 生产基地 | 16,600.00 |
| 建设金卡工程 IC 芯片生产基地 | 24,070.00 |
| 模糊控制专用 IC 芯片技术开发 | 1,597.60 |
| 流动资金 | 11,150.00 |
| 收购北电网络在上海先进半导体有限公司的全部股权 | 14,000.00 |
| 收购上海虹日国际电子有限公司 25.5% 股权 | 1,300.00 |
| 建造数模混合集成电路专用生产厂房 | 11,375.86(注 1) |
| 合 计 | 80,093.46(注 2) |

注 1："建造数模混合集成电路专用生产厂房"项目计划投资人民币 11,375.86 万元的构成情况说明如下：

1999 年募集资金使用项目调整后节余资金人民币 7,044.4 万元；

"发展兼并后的华旭封装分厂生产线"项目取消后结余资金人民币 1,050.00 万元；

"建设通信产品用 IC 生产基地"项目结余 1743.70 万元；

"收购北电网络在上海先进半导体有限公司的全部股权"项目结余人民币 1,507.76 万元；

"收购上海虹日国际电子有限公司 25.5% 股权"结余人民币 30 万元；

注 2:经过项目调整后使用计划总数大于实际募集资金数额,系因为建造数模混合集成电路专用生产厂房的计划投资中已包括了上述 、 、 项的结余资金人民币 3,281.46 万元。

三.募集资金实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件的内容对照如下：

| 序号 | 项目名称 | 实际投资金额 | | | | | 各年度报告和其他信息披露文件 | | | | | 差异说明 |
|----|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|
| | | 1998 年 | 1999 年 | 2000 年 | 2001 年 | 2002 年 | 1998 年 | 1999 年 | 2000 年 | 2001 年 | 2002 年 | |
| 1 | 建设通信产品 | 5,895.00 | 3,447.30 | 5,514.00 | - | - | 5,895.00 | 3,447.30 | 5,514.00 | - | - | |

无差异

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|-----|
| 用 IC 生产基地 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 建设金卡工程 IC | 3,035.00 | 2,312.30 | 1,809.23 | 2,096.49 | 1095.35 | 3,035.00 | 2,312.30 | 1,809.23 | 2,096.49 | 1095.35 | 无差异 |
| 芯片生产基地 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 模糊控制专用 IC | 424.00 | 1,049.70 | 123.90 | - | - | 424.00 | 1,049.70 | 123.90 | - | - | 无差异 |
| 芯片技术开发 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 流动资金 | 1,700.00 | 7,161.70 | 2,288.30 | - | - | 1,700.00 | 7,161.70 | 2,288.30 | - | - | 无差异 |
| 5 | 收购北电网络在 | | | 12,492.24 | - | - | | | 12,492.24 | - | - | 无差异 |
| 上海先进半导体有 | | | | | | | | | | | | |
| 限公司的全部股权 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 收购上海虹日国际 | | 1,270.00 | - | - | - | | 1,270.00 | - | - | - | 无差异 |
| 电子有限公司 25.5% 股权 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 建造数模混合继承电路 | | | | 6,947.25 | 4428.61 | | | | 6,947.25 | 4428.61 | 无差异 |
| 专用生产厂房 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 11,054.00 | 15,241.00 | 22,227.67 | 9,043.74 | 5523.96 | 11,054.00 | 15,241.00 | 22,227.67 | 9,043.74 | 5523.96 | |

四.未全部使用募集资金情况

截止 2002 年 12 月 31 日止,本公司已使用了人民币 63,090.37 万元,尚未使用的募集资金为 " 建设金卡工程 IC 芯片生产基地 " 项目尚未使用资金人民币 13,721.63 万元,均暂存于银行,尚未使用的募集资金占前次募集资金总额的比例为 17.86% 。

上海贝岭股份有限公司
二〇〇三年五月二十八日

附件 2

前次募集资金使用情况专项报告 安永大华业字(2003)第 880 号

上海贝岭股份有限公司董事会：

我们接受委托,审核了 贵公司截至 2002 年 12 月 31 日前的前次募集资金投入情况。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们责任是对这些材料和证据发表审核意见。我们的审核是根据《中国注册会计师独立审计准则》和中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的。在审核过程中,我们结合贵公司的具体情况实施了包括调查、取证等我们认为必要的审核程序。现将审核情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间：

经中国证券监督管理委员会核准, 贵公司于 1998 年 8 月 14 日发行新股。发行股份 12,000 万股,发行股价人民币 6.53 元,募集资金总额为人民币 783,600,000.00 元,扣除发行费用人民币 15,479,578.30 元后实际募集资金数额为人民币 768,120,421.70 元。资金到位时间为 1998 年 8 月 24 日,业经大华会计师事务所以华业字(1998)第 969 号验资报告验证。

二、前次募集资金的实际使用情况：

(一) 前次募集资金的实际使用情况：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 实际投 资金额 | 实际投入时间 | | | | 完工程度 | 产生收益 |
|----|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--------|------|
| | | | 1998 年 | 1999 年 | 2000 年 | 2001 年 | | |
| 1 | 建设通信产品用 IC 生产基地 | 14,856.30 | 5,895.00 | 3,447.30 | 5,514.00 | - | 100% | 注 3 |
| 2 | 建设金卡工程 IC 芯片生产基地 | 10,348.37 | 3,035.00 | 2,312.30 | 1,809.23 | 2,096.49 | 42.99% | 注 3 |

注 1

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------|------------|
| 3 | 模糊控制专用 IC 芯片技术开发 | 1,597.60 | 424.00 | 1,049.70 | 123.90 | - | - | 100% | 注 3 |
| 4 | 流动资金 | 11,150.00 | 1,700.00 | 7,161.70 | 2,288.30 | - | - | 100% | |
| 5 | 收购北电网络在上海先进半导体有限公司的全部股权 | 12,492.24 | - | 12,492.24 | - | - | - | 100% | 16,045 注 2 |
| 6 | 收购上海虹日国际电子有限公司 25.5% 股权 | 1,270.00 | - | 1,270.00 | - | - | - | 100% | 991 注 2 |
| 7 | 建造数模混合集成电路专用生产厂房 | 11,375.86 | - | - | - | 6,947.25 | 4,428.61 | 100% | |
| 8 | 合计 | 63,090.37 | 11,054.00 | 15,241.00 | 22,227.67 | 9,043.74 | 5,523.96 | | |

注 1：由于金卡大规模的推广使用与市场配套条件有很大关联,金卡市场有一个逐步培育、成熟的过程,公司力求对金卡工程 IC 芯片生产基地投入资金的速度与金卡市场需求的速度同步,近二年在金卡基地实际投入和产出的节奏较计划投入产出的要求相对滞后。

注 2：系根据上海贝岭股份有限公司所持股权比例按照权益法核算的累计投资收益。

注 3 募集资金投入的通信产品用 IC 生产基地、金卡工程 IC 芯片生产基地、模糊控制专用 IC 芯片技术开发三个项目所产出的三大类产品,于 1999 年初至 2002 年末累计实现销售收入人民币 92,533 万元,销售毛利人民币 37,628 万元。

(二)募集资金实际使用情况与招股说明书承诺对照如下：

金额单位：人民币万元

| 序号 | 项目名称 | 实际投资金额 | 招股说明书 承诺金额 | 差异说明 |
|----|-------------------------|-----------|---------------|--|
| 1 | 建设通信产品用 IC 生产基地 | 14,856.30 | 16,600.00 | 结余 1743.70 万元已调整至建造数模混合集成电路厂房项目 |
| 2 | 建设金卡工程 IC 芯片生产基地 | 10,348.37 | 24,070.00 | 项目尚未完成 |
| 3 | 增添 6 英寸亚微米生产线专用设备 | 0.00 | 24,900.00 | 项目取消 |
| 4 | 模糊控制专用 IC 芯片技术开发 | 1,597.60 | 597.60 | 调整增加投资人民币 1000 万元 |
| 5 | 改造扩建公司净化厂房 | 0.00 | 24,900.00 | 项目取消 |
| 6 | 发展兼并后的上海华旭微电子公司封装分厂 | 0.00 | 1,050.00 | 项目取消 |
| 7 | 流动资金 | 11,150.00 | 11,150.00 | 无差异 |
| 8 | 收购北电网络在上海先进半导体有限公司的全部股权 | 12,492.24 | 0.00 | 调整新增项目结余人民币 1,507.76 万元已调整至建造数模混合集成电路厂房项目。 |
| 9 | 收购上海虹日国际电子有限公司 25.5% 股权 | 1,270.00 | 0.00 | 调整新增项目结余人民币 30 万元已调整至建造数模混合集成电路厂房项目。 |
| 10 | 建造数模混合集成电路专用生产厂房 | 11,375.86 | 0.00 | 调整新增项目,无差异 |
| | 合计 | 63,090.37 | 103,267.60 | |

公司实际募集资金数额为人民币 76,812 万元。

募集资金项目变更调整情况如下：

1.公司于 1999 年 11 月 9 日召开第一届第七次董事会决定对募集资金作如下调整：

(5) 取消原 "增添 6 英寸亚微米生产线专用设备" 项目；

(6) 取消原 "改造扩建公司净化厂房" 项目；

(7) 出资 1500 万美元收购北电网络公司在上海先进半导体制造有限公司的全部股权；

- (8) 出资 153 万美元收购上海虹日国际电子有限公司 25.5% 的股权；
 (9) 对原 " 模糊控制专用 IC 芯片技术开发 " 项目追加 1000 万元人民币投资。

该募集资金变更方案业经 1999 年 12 月 16 日召开的公司 1999 年度第二次临时股东大会通过。

2.公司于 2001 年 3 月 9 日召开一届十一次董事会,对募集资金进行了调整:

(1) 取消 " 发展兼并后的华旭封装分厂生产线 " 项目;

(2) 结余的募集资金共计人民币 11,375.86 万元,用于投资建设数模混合集成电路芯片专用生产厂房,该项目的建设总投资为人民币 24,813.00 万元,不足部分由公司自筹资金解决。

该项募集资金调整方案业经 2001 年 4 月 13 日召开的公司 2000 年度股东大会通过。

经过上述项目调整后募集资金的使用计划如下:

| 项目名称 | 计划投资人民币万元 |
|-------------------------|-----------|
| 建设通信产品用 IC 生产基地 | 16,600.00 |
| 建设金卡工程 IC 芯片生产基地 | 24,070.00 |
| 模糊控制专用 IC 芯片技术开发 | 1,597.60 |
| 流动资金 | 11,150.00 |
| 收购北电网络在上海先进半导体有限公司的全部股权 | 14,000.00 |
| 收购上海虹日国际电子有限公司 25.5% 股权 | 1,300.00 |
| 建造数模混合集成电路专用生产厂房 | 11,375.86 |
| 合计 | 80,093.46 |

经过项目调整后使用计划总数大于实际募集资金数额,系因为建造数模混合集成电路专用生产厂房的计划投资中已包括了其他项目的结余资金人民币 3,281.46 万元。

(三)募集资金实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件的内容对照如下:

| 序号 | 项目名称 | 实际投资金额 | | | | | 各年度报告和其他信息披露文件 | | | | | 差异说明 |
|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|------|
| | | 1998 年 | 1999 年 | 2000 年 | 2001 年 | 2002 年 | 1998 年 | 1999 年 | 2000 年 | 2001 年 | 2002 年 | |
| 1 | 建设通信产品用 IC 生产基地 | 5,895.00 | 3,447.30 | 5,514.00 | - | - | 5,895.00 | 3,447.30 | 5,514.00 | - | - | 无差异 |
| 2 | 建设金卡工程 IC 芯片生产基地 | 3,035.00 | 2,312.30 | 1,809.23 | 2,096.49 | 1,095.35 | 3,035.00 | 2,312.30 | 1,809.23 | 2,096.49 | 1,095.35 | 无差异 |
| 3 | 模糊控制专用 IC 芯片技术开发 | 424.00 | 1,049.70 | 123.90 | - | - | 424.00 | 1,049.70 | 123.90 | - | - | 无差异 |
| 4 | 流动资金 | 1,700.00 | 7,161.70 | 2,288.30 | - | - | 1,700.00 | 7,161.70 | 2,288.30 | - | - | 无差异 |
| 5 | 收购北电网络在上海先进半导体有限公司的全部股权 | - | - | 12,492.24 | - | - | - | - | 12,492.24 | - | - | 无差异 |
| 6 | 收购上海虹日国际电子有限公司 25.5% 股权 | - | 1,270.00 | - | - | - | - | 1,270.00 | - | - | - | 无差异 |
| 7 | 建造数模混合集成电路专用生产厂房 | - | - | - | 6,947.25 | 4,428.61 | - | - | - | 6,947.25 | 4,428.61 | 无差异 |
| 8 | 合计 | 11,054.00 | 15,241.00 | 22,227.67 | 9,043.74 | 5,523.96 | 11,054.00 | 15,241.00 | 22,227.67 | 9,043.74 | 5,523.96 | |

(四)募集资金实际使用情况与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》对照表如下:

| 序号 | 项目名称 | 实际投资金额 | 董事会 《关于前 次募集资 | 差异说明 |
|----|------|--------|---------------------|------|
|----|------|--------|---------------------|------|

| | | | | 金使用情 况的说明》 披露金额 |
|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 | 建设通信产品用 IC 生产基地 | 14,856.30 | 14,856.30 | 无差异 |
| 2 | 建设金卡工程 IC 芯片生产基地 | 10,348.37 | 10,348.37 | 无差异 |
| 3 | 模糊控制专用 IC 芯片技术开发 | 1,597.60 | 1,597.60 | 无差异 |
| 4 | 流动资金 | 11,150.00 | 11,150.00 | 无差异 |
| 5 | 收购北电网络在上海先进半导 体有限公司的全部股权 | 12,492.24 | 12,492.24 | 无差异 |
| 6 | 收购上海虹日国际电子有限公 司 25.5% 股权 | 1,270.00 | 1,270.00 | 无差异 |
| 7 | 建造数模混合集成电路专用生 产厂房 | 11,375.86 | 11,375.86 | 无差异 |
| 8 | 合 计 | 63,909.37 | 63,909.37 | |

三、未全部使用募集资金情况

截至 2002 年 12 月 31 日止,公司尚未使用的募集资金为人民币 13,721.63 万元,均暂存于银行,尚未使用的募集资金占前次募集资金总额的比例为 17.86%,全部将继续投入 " 建设金卡工程 IC 芯片生产基地 " 的资金,公司董事会已对结余资金进行了安排。

我们认为, 贵公司董事会说明、有关信息披露文件中关于司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

本专项报告仅供 贵公司本次发行新股之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为 贵公司申请发行新股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。

安永大华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

许逸星

袁勇敏

中国 上海 昆山路 146 号

2003 年 5 月 29 日